

Title (en)
IMPROVED COMPOSITE DIELECTRIC.

Title (de)
DIELEKTRISCHES KOMPOSIT.

Title (fr)
DIELECTRIQUE COMPOSITE AMELIORE.

Publication
EP 0494204 A1 19920715 (EN)

Application
EP 90914380 A 19900917

Priority
US 41232889 A 19890925

Abstract (en)
[origin: WO9104562A1] A low-temperature-sintering, ceramic-filled-glass composite dielectric for microelectronic packaging has been developed that consists of 30-76 % (by volume) of a low dielectric constant, refractory ceramic filler or mixture of fillers, and 24-70 % of non-crystallizing, reduction resistant, alkaline-earth alumino-borate glass.

Abstract (fr)
On a mis au point un diélectrique composite en verre rempli de céramique, à basse température de frittage, destiné à la mise sous boîtier microélectronique, comprenant 30 à 76 % (en volume) d'une matière de remplissage en céramique réfractaire, de faible constante diélectrique ou un mélange de matières de remplissage, et 24 à 70 % de verre de borate alumineux alcalino-terreux non cristallisant, résistant à la réduction.

IPC 1-7
C03C 14/00; **H01B 3/08**; **H01B 3/12**; **H05K 1/03**

IPC 8 full level
C03C 14/00 (2006.01); **H01B 3/08** (2006.01); **H01L 23/15** (2006.01); **H05K 1/03** (2006.01)

CPC (source: EP)
C03C 14/004 (2013.01); **H01B 3/085** (2013.01); **H01B 3/087** (2013.01); **H01L 23/15** (2013.01); **C03C 2214/04** (2013.01); **H01L 2924/0002** (2013.01); **H01L 2924/09701** (2013.01); **H05K 1/0306** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 9104562A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9104562 A1 19910404; EP 0494204 A1 19920715; JP H05500584 A 19930204

DOCDB simple family (application)
US 9005170 W 19900917; EP 90914380 A 19900917; JP 51344290 A 19900917